


短 信

2022年度事業概要報告及び2023年度事業計画の概要

2023年3月31日

 株式会社 **ダン・タクマ**

目 次

事業概要報告の資料（2022年度）

1. 事業概要報告	1 - 3
2. 財務・業績概要	4
4 国内外売り上げ推移の概要	5
5 品目別売上構成比率 / 売上げ内外比率	6
6. 研究開発活動	7

事業計画概要の資料（2023年度）

5. 事業戦略概要	8 - 10
6. 研究開発項目	11

事業概要報告

(2022年4月1日 から 2023年3月31日)

当社の第54期に於ける事業概要につきまして、以下の通り簡単にご報告申し上げます。

1. 株式会社の現況に関する重要な事項

(1) 事業の経過及びその成果

当社の事業の柱は、その生産プロセスに於いて、高度にクリーンな環境が求められる半導体および関連する電子デバイス・精密加工産業の分野に於ける各種クリーン機器・装置の供給並びにメンテナンスに係わるビジネスであり、半世紀余に亘り当該分野に注力し事業継続してまいりました。

2022年度の事業を取り巻く市場環境については、一般紙に於いても頻繁に紙面を賑わしたように半導体及び電子デバイス業界の最近数年に亘る活況は既にピークアウトし 分野によっては減産・在庫生産調整の段階に移行したと報じられる一方で 米中貿易戦争に於ける米国による中国排除施策・世界のグローバルサプライチェーンの分断によるデ・カップリング化、経済安全保障の観点より各国政府主導による自国半導体工場の建設拡大などにより 一部半導体製造装置の需要は旺盛に維持されるような特徴的な状況が続きました。 業界の活況は既にピークアウトし 低迷期に入るも新工場の建設計画の実施は続き 更に其れとは異なる事由に因り 依然半導体の不足は顕著且つ状況の解消目途は立たず 直線的な見方では現実的な外部環境の把握や販売戦略の立案が容易でない事業年度になります。

そのような外部環境の中、 当社の事業は以下のような進捗概要を辿ります：

第1四半期は、業界では有名になった「半導体製造装置に用いる半導体が手に入らない」と形容される世界的な半導体不足の下で 出だしのタイミングとしては相応に大きな新規受注を獲得し 予定以上の進捗を為し、依然 市場の旺盛な需要を実感することになります。 一方 売上額は通期計画に対し、新規受注の進捗の高さは見せず 調達市場におけるリードタイムの拡大が依然解消傾向に非らず「受注残の売上移行が緩慢」という懸念の顕在化傾向が見受けられるスタートとなりました。

第2四半期に於いても 混沌とした世界情勢の下、先端半導体を核とする米中貿易戦争は細部の許可制度にまで及び様相を呈してきます。新聞業界紙報道による半導体電子デバイス関連銘柄の株価の下落や半導体製造分野における減産・下方修正検討の情報が多く見受けられ 当社の見立よりも早い 業界活況のピークアウトを判断すべき時期を迎えます。然し乍ら 新規受注の当期累積は 通期計画に対し既に目標達成を射程内に捉える勢いで進捗します。 一方、売上は 新規受注獲得程の勢いはなく、更に売上利益の水準については円安による輸入材料の原価上昇と国際営業物件に於ける輸出品目付随現地役務項目のコスト上昇による利益低減傾向が顕著に可視化されます。

第3四半期に入り、半導体不足といわれる 車載・パワー半導体等アナログ・個別半導体の非常に旺盛な需要は その生産規模の事由に因り依然解消の気配は小さいものの、半導体の70%以上を占めるメモリ・ロジック・マイクロ等に於いて製造設備の材料・構成部品の調達市場の逼迫の解消を待たぬ状況でのピークアウトが顕著になり当該業界分野に業績下方修正・生産在庫調整の傾向が顕著になってきます。

マーケットの状況に拘わらず、新規受注の順調な獲得に依り受注額は通期目標を超える勢いであり、懸念された売上についても受注程の勢いは無いものの安定した進捗となった為、此処に於いて通期計画の上方修正を致します。然し乍ら国際営業物件の利益率の低下と内部環境・基盤機能整備により増加が見込まれる販管費・固定総額の発生進捗がまだ低く、経常利益額の見立について、この時点ではまだ楽観視し難い状況です。

最終、第4四半期に入り既受注分の期末までの売上・進行基準などの詳細確認と併せ、輸出案件に於いては国策といえるようなデマンドの下、中国既存顧客向けに相応に纏まった規模の新規受注の獲得があり、結果的には更なる大幅受注拡大となり、販管費・固定費についても増額となりますが、経常利益も見込みを上回り2期連続で過去最高となった昨年度を超える事業成果獲得、すなわち3期連続での過去最高益の成果獲得という結果になりました。

受注・売上・利益などの情報については、後述の「54期 財務・業績概要」を参照ください。

(2) 主な事業内容

- ① 以下の装置・設備・製品の計画・販売・手配・供給、メンテナンス、改良開発ならびに一部輸出取引など
半導体製造・電子精密加工業界向け
クリーンエア機器・設備、ケミカルフィルタ、磁気シールドルーム・PIオープン設備など
- ② その他 半導体・電子業界向けを含む クリーン関連商品の開発、製品化、販売、メンテナンス
マイクロバブル発生洗浄装置の開発、乾燥装置、AMC環境濃度測定器などの開発、販売
メンテナンスなど

(3) 主な事業所の状況

(2023年3月31日現在)

事業所名称	所在地
本 社	神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目19番1号 (LIVMOライジングビル)
名古屋支店	愛知県名古屋市西区平出町308番
九州支店	福岡県福岡市中央区長浜1丁目3番4号 (綾杉ビル北天神)
けいはんなテクニカルセンター	京都府相楽郡精華町光台1丁目7番 (スーパーラボ棟)
東北出張所	岩手県北上市鍛冶町2丁目14番37号

(4) 従業員の状況

(2023年3月31日現在)

- 従業員数： 74 名 役員・顧問、派遣等を含み 計 94 名
- 平均年齢： 46.6歳 (役員・顧問・派遣などを除く)
- 平均勤続年数： 12.5 年 (同 上)

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

当社の親会社は株式会社タクマであり、同社は当社（資本金90百万円）の株式を180,000株（出資比率100%）保有しています。

② 子会社の状況 (該 当 な し)

第54期 財務・業績概要

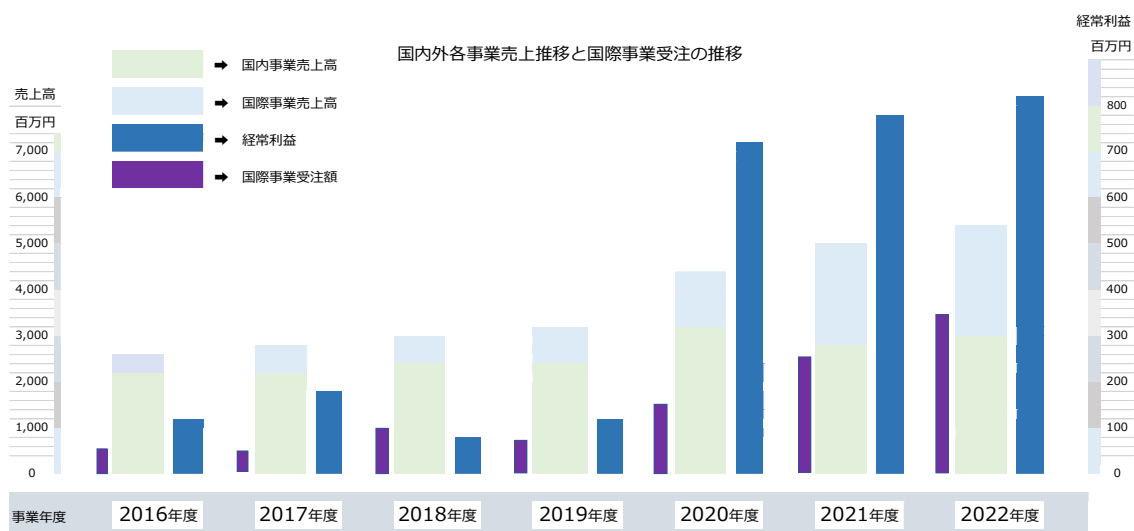
(百万円)

科 目	当期末 2023.3	前期末 2022.3	対前期末増減	
1] 受注高など				
受注高	6,841	6,198	643	10.4%
次期繰越受注残	4,134	2,684	1,450	54.0%
2] 損益計算書概要				
売上高	5,392	5,012	380	7.6%
売上総利益	1,623	1,544	79	5.1%
販管費	812	754	58	7.7%
営業利益	811	790	21	2.7%
経常利益	823	781	42	5.4%
当期純利益	539	520	19	3.7%
3] 貸借対照表概要				
資産				
流動資産	4,408	4,280	128	3.0%
固定資産	319	300	19	6.3%
資産合計	4,727	4,580	147	3.2%
負債				
流動負債	1,922	2,064	-142	△ 6.9%
固定負債	114	110	4	3.6%
負債合計	2,036	2,174	-138	△ 6.3%
純資産				
資本金	90	90	0	0.0%
利益剰余金	2,584	2,297	287	12.5%
評価換算差額	17	18	-1	△ 5.6%
純資産合計	2,691	2,405	286	11.9%
4] 自己資本				
自己資本比率	56.9%	52.5%	4.4%	8.4%

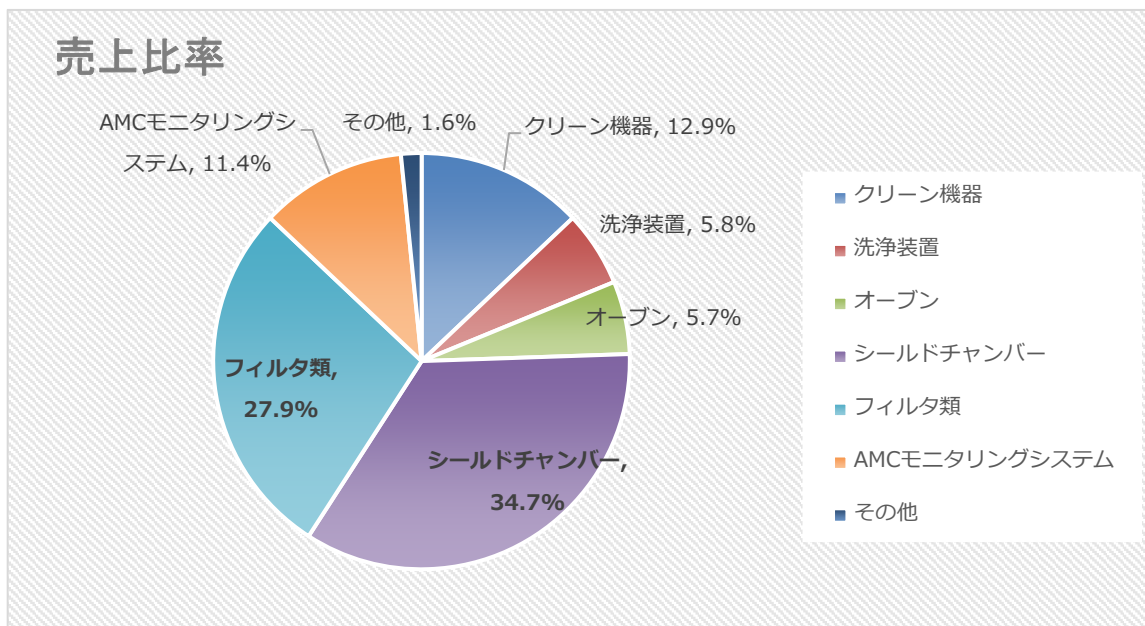
国内外売上推移の概要

2016年度から2022年度までの事業進捗の概要

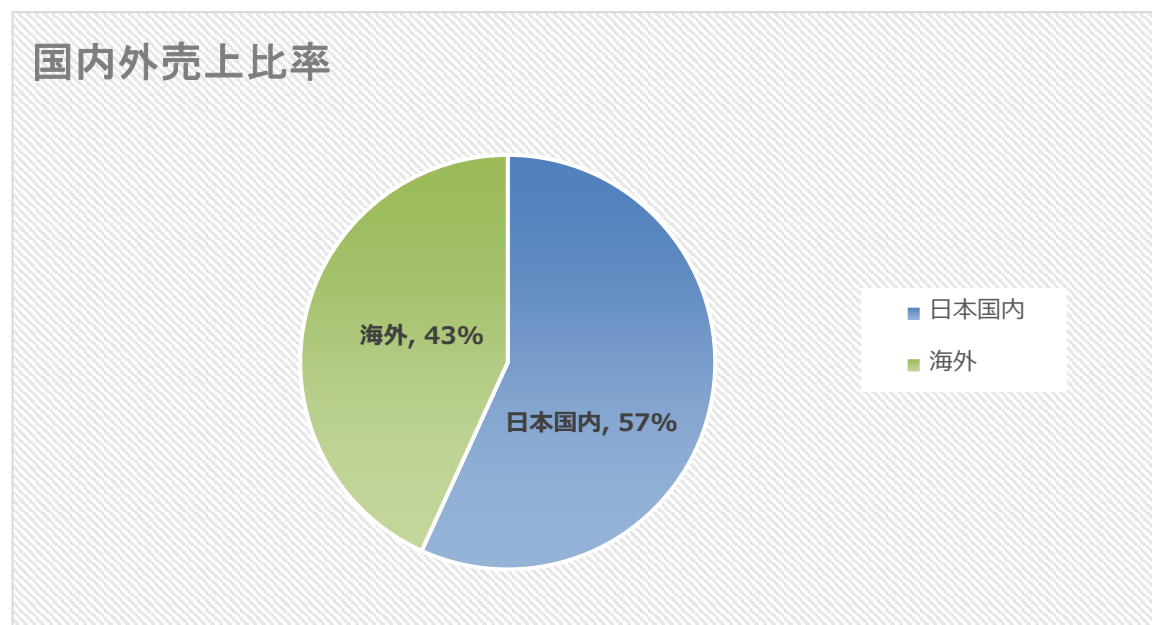
以下に示す通りの事業進捗により「長期ビジョン Vision 2030」に於ける目標の達成に向けて事業活動を継続しています。



第54期 品目別売上構成比率



第54期 売上内外比率



2022年度 第54期研究開発一覧

研究開発の名称	研究内容・目的
洗淨技術開発	<p>半導体、電子部品などの洗淨プロセスに関連する技術を開発し、既存製品(洗淨機)のラインナップの拡充と、独自技術による付加価値の高い製品の開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロバブルを応用した洗淨技術とその搭載装置の開発 ・東北大学との共同研究
新規ケミカルフィルタの開発	<p>半導体工場内の化学汚染物質制御に資するケミカルエアフィルタおよび微量ガス連続分析装置に関する開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種ケミカルエアフィルタろ材の開発・評価、原材料・製造方法検討 ・微量ガス連続分析装置（DTアナライザ）のシステム及びデータ収集・通信ソフトの開発
磁気シールド技術開発	<p>半導体製造工場で使用される電子ビーム描画装置の運転に必要な不可欠な磁気シールドの技術開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シールド材料の磁気特性評価 ・焼鈍条件の検討

事業戦略概要

(2023 年度)

1. 事業をとりまく環境

外部環境（市場環境）

2023 年の半導体市場については、WSTS(世界半導体市場統計)によると 4 年ぶりのマイナス成長（対前年比▲4.1%）との見込みが報じられています。

2022 年には対前年比 4.4% 増となり 其の前年 2021 年の 26.2% 増から大幅に成長が鈍化し、市況は同年（2022 年）にピークを迎え 同時にピークアウトし、2023 年～2024 年に於けるグローバル市場は、半導体供給不足への対応策で積み増していた生産・在庫調整のプロセスに移行するとみられています。一方、車載半導体の高度化・高性能化・再生エネルギー・産業用計器制御用などについての需要は依然旺盛であり、同一業界に於いても市況の二極化が指摘されています。

新型感染症によるパンデミックの影響は鎮静傾向に転じたものの、ロシアによるウクライナ侵攻、米中貿易戦争、経済安全保障上の観点によるグローバルサプライチェーンの分断、デカップリングと国策的自国半導体工場の誘致建設、続く円安傾向など先行き不透明な世界情勢は続いてゆくものと推測されます。

内部環境

2020 年度、2021 年度、2022 年度と 3 期連続で過去最高益の事業成果獲得となり、当社の事業に於けるポテンシャルの顕在化を為すことになりましたが、同時に これら獲得成果の水準による事業継続・持続的拡大への安定的な成長の維持にこれから取り組む事となります。内部基盤の機能向上の為の改善・改変の着実な実施と安定的定着も 事業継続と持続的拡大・成長には必須要素となります。

活況からピークアウトし停滞期に入ったと言われる外部環境の下、固定費総額の上昇を緩慢に抑えるところに努め乍らも、当社の持続可能な事業拡大・成長の維持へのデマンドを満たす内部基盤機能の向上の為の整備・再構築に取り組んでゆきます。

2. 事業戦略に於ける基本方針

事業の基本方針と重点事項

中期経営計画最終年度 2023 年度の事業遂行と成果獲得に向けて 以下の事項に注力し事業を進めて参ります。

- 現行中期経営計画の基本方針による業務遂行と目標達成
- 固定費総額の増加速度を抑制した基盤機能改変・構築の実行
- 内部編制の機能向上に向けた再構築の検討
- 以下の事業項目・テーマにつき推進強化と成果獲得の道筋を明確化します。
 - 1) 「中国製造 2025」の下での販売事業拡大と水平展開の検討
 - 2) 開発・差別化商品への注力と見極め
 - 3) 営業販売戦略の再構築と商機拡大
 - 4) BCP の構築
 - 5) 基盤機能構築・改変に於ける喫緊の必至事項への戦略的対処

3. 事業成果に関する指針

現行第 13 次中期経営計画最終年度に於ける目標達成へのアプローチ

2023 年、今年度に於いて第 13 次現行中期経営計画の最終年度を迎え、当該中期経営計画に於ける売上高・営業利益・経常利益の 3 年間の合計が、上方修正を含み最終設定した目標を達成できるように、中期経営計画の基本方針に則り 社員全員が力を合わせて重要施策の実施及び注力事案に鋭意取り組むことを再確認致します。

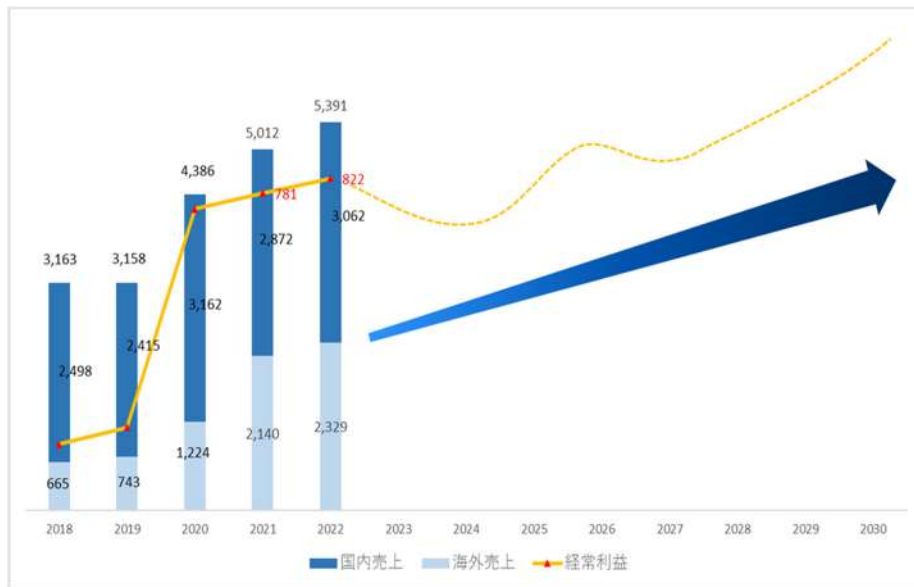
また、中期経営計画基本方針設定時の「3 年後の到達点：最終年度の進捗想定」に描かれた絵姿をクリアし得る進捗状況を目指すものと致します。

4. 中長期に亘る考察

現在 タクマグループ長期ビジョン Vision 2030 に於ける初動の3年間として位置付けられた第13次現行中期経営計画の最終年度に於いて、鋭意目標達成に向け事業活動を行っています。

来年度から開始となる次期新中期経営計画に向け、今年度の事業活動の中で現行中期経営計画の総括を実施するタイミングでもあります。

当社は 現行中期経営計画の総括と、残された期間の業務遂行による設定目標達成を志向すると共に次期新中期経営計画に於いて Vision 2030 の設定目標の達成に繋がる事業活動成果の獲得を行うべく具体的な実施計画の準備を致します。



- * 海外・国際事業を中心とする販売事業の大幅商機拡大
- * 国内販売事業の安定的維持と逡増的成長の志向
- * 戦略的施策の成果獲得に依る市場変動インパクトの緩和
- * 事業の安定的成長を支える内部基盤機能の更なる向上と構築

2030年度に於ける設定目標の達成に向けて、現行中期経営計画に引き続き上記の事項を基本的なフレームワークとして、各々の事項の具現化による目標達成の為戦略的な実施施策の策定を行います。

戦略的実施施策による獲得成果が 当該業界分野における市場の好不況の影響を緩衝し、長期に亘る持続可能な逡増的事业拡大・成長を助勢するものと考えております。

以上

2023年度 55期研究開発項目

研究開発の名称	研究内容・目的
洗淨技術開発	<p>半導体、電子部品などの洗淨プロセスに関連する技術を開発し、既存製品(洗淨機)のラインナップの拡充と、独自技術による付加価値の高い製品の開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロバブルを応用した洗淨技術とその搭載装置の開発 ・東北大学との共同研究
新規ケミカルフィルタの開発	<p>半導体工場内の化学汚染物質制御に資するケミカルエアフィルタおよび微量ガス連続分析装置に関する開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種ケミカルエアフィルタろ材の開発・評価、原材料・製造方法検討 ・微量ガス連続分析装置（DTアナライザ）のシステムの検討評価
磁気シールド技術開発	<p>半導体製造工場で使用される電子ビーム描画装置の運転に必要不可欠な磁気シールドの技術開発を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シールド材料の焼鈍条件と磁気特性の関連評価 ・磁界解析による、シールド性能を最適化する磁気シールドチャンバの加工・設計・施工条件の検討 ・磁界キャンセラの性能向上、環境に応じた運転の最適化のための実験評価